

06.3;07;12  
©1994

**ИССЛЕДОВАНИЕ ВИДИМОЙ  
ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ ИЗ ТОНКИХ  
ПЛЕНОК  $\text{SiO}_x$ , ПОЛУЧЕННЫХ  
МЕТОДОМ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОГО  
ПЛАЗМОХИМИЧЕСКОГО ОСАЖДЕНИЯ**

*Ф.Н. Тимофеев, А.Айдинли, Ш.Сюзар, Р.Эллиолтиоглы,  
М.Гюре, К.Тюркоглы, В.Н.Михайлов, И.Н.Тимофеев*

В последнее время появилось значительное количество публикаций, посвященных исследованию фотолюминесценции (ФЛ) в видимом диапазоне длин волн из непрямозонных материалов, содержащих кремний в виде наноразмерных кристаллитов — пористый кремний [1,2], кластеры кремния в матрице  $\text{SiO}_2$  [3,4] и т. д. Двуокись кремния–кремний являются естественной и достаточно хорошей гетеропарой, что позволяет надеяться на эффективную локализацию волновых функций носителей заряда в “квантовых точках” из Si, помещенных в матрицу  $\text{SiO}_2$ . Плазмохимическое осаждение (ПХО), а также различные модификации этой технологии являются одним из наиболее гибких и простых методов, позволяющих получать на поверхности различных материалов планарные пленки субокислов кремния (в частности,  $\text{SiO}_2$ ) с различной стехиометрией [5] при пониженной температуре роста [6]. В данной работе мы приводим результаты исследования люминесцентных свойств пленок  $\text{SiO}_x$ , полученных методом ПХО при температуре осаждения 100°C, и влияние на них последующего фотонного отжига пленок в атмосфере аргона.

Пленки  $\text{SiO}_x$  толщиной 70–1000 нм выращивались на поверхности  $p\text{-Si}(100)$  и  $n^+\text{-GaAs}(100)$  подложек методом ПХО (PECVD) на установке Plasmalab μR из газов: чистый  $\text{N}_2\text{O}$  и смесь  $\text{SiH}_4(2\%) + \text{Ar}(98\%)$ . Циклы нанесения пленок проводились при давлении в рабочей камере 1.0 Тор, мощности ВЧ генератора 7 Вт, температуре подложкодержателя 100°C и различной величине газового потока  $\text{N}_2\text{O}$  (0–900 см<sup>3</sup>/мин). Величина газового потока смеси силана с аргоном во всех экспериментах была постоянной (180 см<sup>3</sup>/мин). Скорость роста пленок определялась из измерений их толщины с помощью профилометра “Dectak” (либо оптическим способом на установке “NanoSpec/AFT”) и известного времени выра-

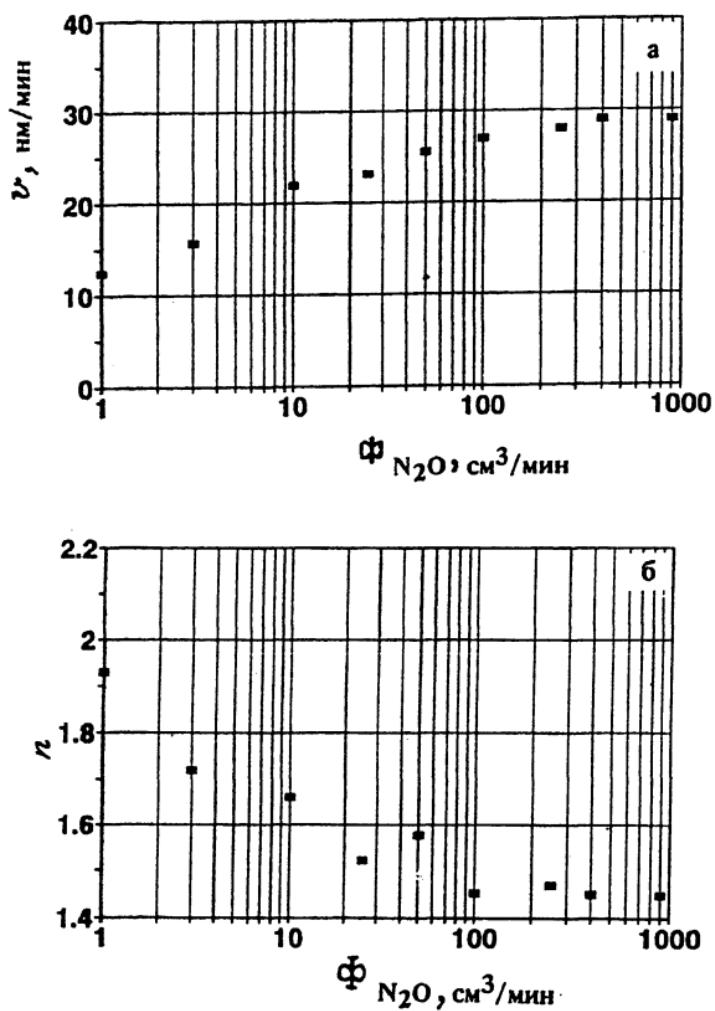


Рис. 1. Зависимости: *a* — скорости роста, *б* — показателя преломления пленок  $\text{SiO}_x$  от величины газового потока  $\text{N}_2\text{O}$ . Пленки выращены методом ПХО при  $T = 100^\circ\text{C}$ ,  $P = 1.0 \text{ Torr}$ , постоянном потоке смеси газов  $(2\%) \text{SiH}_4 + \text{Ar}(98\%)$   $180 \text{ cm}^3/\text{мин}$  и мощности ВЧ разряда 7 Вт.

щивания. На рис. 1,*a* приведена зависимость скорости роста пленок  $\text{SiO}_x$  на подложке  $p\text{-Si}(100)$  от величины газового потока  $\text{N}_2\text{O}$ . Видно, что увеличение парциального давления кислорода в камере (при увеличении газового потока  $\text{N}_2\text{O}$ ) приводит к увеличению скорости роста пленок. На рис. 1,*б* показана зависимость показателя преломления пленок  $\text{SiO}_x$  от величины газового потока  $\text{N}_2\text{O}$ . Пленки, выращенные при максимальном потоке  $\text{N}_2\text{O}$  соответствуют совершенной двуокиси кремния (что подтверждается исследованием их инфракрасных спектров поглощения и скорости химического травления). Как это и ожидалось, уменьшение содержания ионов кислорода в камере при уменьшении газового потока  $\text{N}_2\text{O}$  приводит к увеличению показателя преломления пленок за счет увеличения концентрации в них кремния

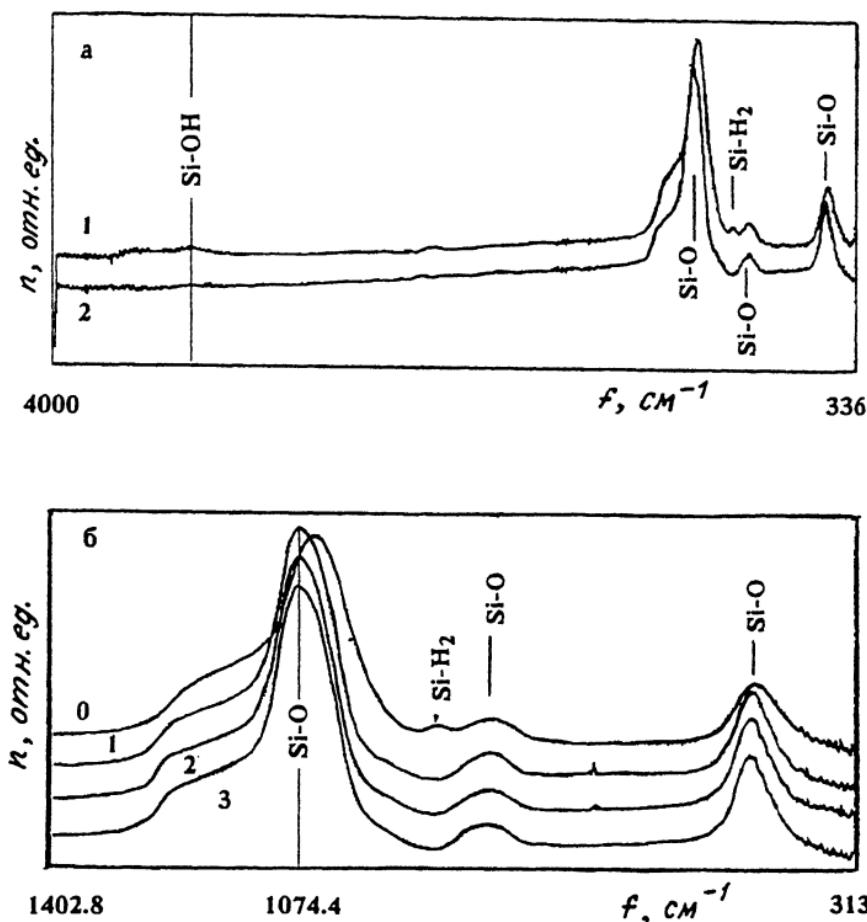


Рис. 2. Спектры ИК поглощения пленок  $\text{SiO}_x$ , полученных при газовом потоке  $\text{N}_2\text{O}$ .

*a* —  $10 \text{ см}^3/\text{мин}$ : 1 — сразу после выращивания, 2 — после 5-минутного фотонного отжига в атмосфере  $\text{Ar}$  при температуре  $750^\circ\text{C}$ ; *б* —  $50 \text{ см}^3/\text{мин}$ : 0 — сразу после выращивания, 1–3 — после отжига в  $\text{Ar}$  при  $750^\circ\text{C}$  в течение 1.5 и 10 мин соответственно.

Пленки выращены методом ПХО на  $\text{Si}$  подложке при  $T = 100^\circ\text{C}$ ,  $P = 1.0 \text{ Тор}$ , ВЧ мощности 7 Вт, при газовом потоке  $(2\%) \text{SiH}_4 + \text{Ar}(98\%)$   $180 \text{ см}^3/\text{мин}$ .

( $x < 2$ ). Избыточный кремний в матрице стекла при определенных условиях имеет тенденцию к образованию кластеров, что было продемонстрировано, например, в работе [4]. Исследования инфракрасных спектров поглощения пленок  $\text{SiO}_x$  ( $x < 2$ ), проведенные в диапазоне  $200$ – $4000 \text{ см}^{-1}$  с использованием инфракрасного Фурье-спектрометра (ИКФС) “Вомет” с разрешением  $2 \text{ см}^{-1}$  и усреднением по 100 сканированиям, показали наличие в пленках кремния, частично связанного с кислородом (высокочастотное “плечо” у основного пика поглощения  $\text{Si}-\text{O}$  связи  $1065 \text{ см}^{-1}$ , рис. 2,*a*,

кривая 1). Величина этого "плеча" увеличивалась в спектрах поглощения пленок, выращенных при малом потоке газа  $N_2O$ , что сопровождалось некоторым уширением пиков поглощения Si-O связи ( $1065, 820, 460\text{ см}^{-1}$ ). Отметим, что в спектрах ИК поглощения исследуемых пленок мы обнаружили очень слабые полосы, соответствующие наличию химических связей Si-O-H ( $3300\text{--}3600\text{ см}^{-1}$ ) и Si-H<sub>2</sub> ( $910\text{--}920\text{ см}^{-1}$ ). Эти слабые полосы практически исчезали после 1–3-минутного отжига пленок в атмосфере аргона (рис. 2,а, кривая 2). На рис. 2,б приведена серия спектров ИК поглощения в пленке  $SiO_x$ , выращенной при величине газового потока  $N_2O$   $10\text{ см}^3/\text{мин}$  до (спектр 0) и после фотонного отжига в атмосфере Ar в течение одной (спектр 1), пяти (спектр 2) и десяти (спектр 3) минут. Процесс фотонного отжига привел к существенному уплотнению структуры пленки, которое видно из сдвига положения пика поглощения Si-O связи с  $1059$  до  $1074\text{ см}^{-1}$ , а также сужения пиков поглощения. Интересно отметить, что стабилизация основных структурных изменений в пленке, а также десорбция водорода (исчезновение пика Si-H<sub>2</sub> связи) произошли уже после первой минуты фотонного отжига (рис. 2,б, спектры 0, 1).

Исследование ФЛ свойств пленок  $SiO_x$  проводилось при комнатной температуре на стандартной установке, состоящей из  $Ar^+$  лазера, двойного монохроматора и системы регистрации со счетом фотонов. Сигнал ФЛ в образцах возбуждался лазерной линией  $476.5\text{ нм}$ . Излучение лазера фокусировалось на образец в виде полосы размером  $0.2 \times 10\text{ мм}$ . Все спектры приведены без коррекции на спектральную чувствительность измерительной установки. Проведенные нами исследования фотолюминесценции показали, что практически все выращенные пленки  $SiO_x$  излучают свет в видимом диапазоне длин волн, причем уменьшение газового потока  $N_2O$  приводит к постепенному смещению максимума полосы люминесценции в красную область, а интенсивность сигнала ФЛ для пленок, выращенных при величине газового потока  $N_2O$   $25\text{--}150\text{ см}^3/\text{мин}$ , оказалась максимальной и уменьшалась для пленок, полученных при газовом потоке  $N_2O$ , отличном от указанных. На рис. 3,а приведен спектр ФЛ пленки  $SiO_x$  толщиной около  $1000\text{ нм}$ , выращенной на подложке  $n^+ \text{-GaAs}$  (спектр 1) при описанных выше условиях и величине газового потока  $N_2O$   $10\text{ см}^3/\text{мин}$ . Широкая полоса с максимумом около  $520\text{ нм}$  соответствует люминесценции из  $SiO_x$ , а пик большей интенсивности с максимумом в районе  $865\text{ нм}$  связан с ФЛ из GaAs подложки. На рис. 3,а приведен спектр ФЛ этой же пленки  $SiO_x$ , но после 5-минутного фотонного отжига при температуре  $750^\circ\text{C}$ .

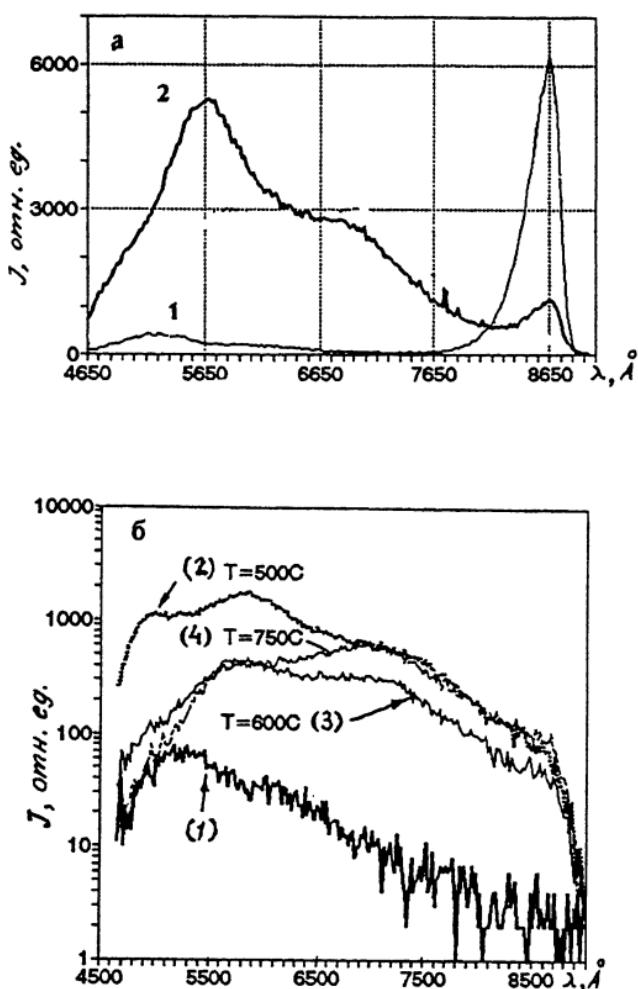


Рис. 3. Спектры ФЛ пленки  $\text{SiO}_x$ , выращенной методом ПХО на подложках.

*a* —  $n^+$ -GaAs: 1 — сразу после выращивания, 2 — после 5 мин отжига в Ar при  $750^\circ\text{C}$ ; *b* —  $p$ -Si: 1 — сразу после выращивания, 2–4 — после отжига в Ar в течение 5 мин при температуре  $500$ ,  $600$  и  $750^\circ\text{C}$  соответственно.

(спектр 2) в атмосфере Ar. Видно, что интенсивность полосы, связанной с люминесценцией из  $\text{SiO}_x$  увеличилась после отжига примерно на порядок, что свидетельствует об увеличении эффективности излучательной рекомбинации в этом материале, в то время как интенсивность полосы люминесценции из GaAs (865 нм) уменьшилась из-за увеличения коэффициента поглощения в пленке  $\text{SiO}_x$  излучения Ar лазера. Отметим также, что отжиг в Ar привел к сдвигу в красную область спектрального положения максимума полосы ФЛ из пленки  $\text{SiO}_x$ , а также к появлению заметного длинноволнового "хвоста". Исследования показали, что осцилляции интенсивности в спектре ФЛ  $\text{SiO}_x$  имеют интерференционную природу.

Рис. 3,б иллюстрирует влияние фотонного отжига в атмосфере Ar на спектры ФЛ пленок  $\text{SiO}_x$ , выращенных в аналогичных условиях на кремниевой подложке. Максимум спектра ФЛ из неотожженной пленки также находился около 520 нм. Отжиг всех пленок проводился в течение 5 мин. Из рисунка видно, что (как и в случае пленок  $\text{SiO}_x$  на GaAs) отжиг уже при температуре 500°С приводит к резкому росту интенсивности сигнала фотолюминесценции из  $\text{SiO}_x$ , а также к сдвигу максимума спектра в красную область и уширению полосы фотолюминесценции за счет роста интенсивности в спектральной области 600–900 нм. Разница в положении максимумов спектров ФЛ для исходной и отожженной при 750°С пленок составила около 180 нм. При увеличении температуры отжига свыше 500°С наблюдается некоторое уменьшение амплитуды интенсивности ФЛ в максимуме спектрального распределения, в то время как интегральный сигнал ФЛ растет вплоть до температуры отжига 800°С. Интересно также отметить, что интегральный сигнал ФЛ в пленках  $\text{SiO}_x$ , не подвергнутых процедуре фотонного отжига, имел тенденцию к деградации во времени. Эта деградация сигнала ФЛ практически отсутствовала в пленках, подвергнутых фотонному отжигу в атмосфере Ar.

Наблюдаемая фотолюминесценция в видимом диапазоне длин волн из пленок  $\text{SiO}_x$ , выращенных методом низкотемпературного ПХО, может быть объяснена в рамках модели, подразумевающей наличие в матрице окисла кремния наноразмерных кремниевых кластеров, образующихся в матрице окисла в процессе роста из газовой фазы, обедненной кислородом. Последующий отжиг пленок в атмосфере Ar приводит к частичному “заличиванию” интерфейса Si кластеров с окружающей матрицей окисла Si, а также к рекристаллизации структуры нанокластеров. Увеличение температуры фотонного отжига приводит, с одной стороны, к увеличению вероятности процесса объединения мелких кластеров в более крупные образования, а с другой стороны, увеличивается вероятность полного окисления и исчезновения мелких кластеров Si. Таким образом, процесс отжига пленок должен приводить к смещению распределения по размерам нанокластеров в область больших и средних размеров, а также к улучшению структуры и интерфейса отдельных кластеров. Экспериментально наблюдаемые увеличение интенсивности ФЛ и “красный сдвиг” максимума спектрального распределения ФЛ из пленок  $\text{SiO}_x$  находят объяснения в рамках изложенной модели. Исследования ИК спектров поглощения пленок  $\text{SiO}_x$  показали отсутствие в их структуре других химических веществ, которые могли бы быть ответственны за наблюдавшуюся полосу ФЛ в видимом диапазоне. Исследования структуры пленок метода-

ми рентгеновской дифрактометрии показали наличие в них кремниевых нанокластеров, находящихся в упорядоченном виде. Результаты более подробных исследований видимой ФЛ из пленок  $\text{SiO}_x$  (температурные, временные и структурные) будут опубликованы в отдельной работе.

Авторы признательны Б.В.Егорову, Н.Н.Фалееву, О.А.Лавровой за помощь в проведении исследований пленок.

### Список литературы

- [1] *Canham L.T.* // Appl. Phys. Lett. 1990. V. 57. P. 1046–1048.
- [2] *Takagahara T., Takeda K.* // Physical Review B. 1992. V. 46. N 23. P. 15 578–15 581.
- [3] *Osaka Y., Tsunetomo K., Toyomura F., Myoren H., Kohno K.* // Jap. J. Appl. Phys. 1992. V. 31. P. L365–L366.
- [4] *Shimizu-Iwayama T., Ohshima M., Niimi T., Nakao S., Saitoh K., Fujita T., Itoh N.* // J. Phys. Condens. Matter. 1993. V. 5. P. L375–L380.
- [5] *Adams A.C., Alexander F.B., Capio C.D., Smith T.E.* // J. Electrochem. Soc. 1981. V. 128. P. 1545–1549.
- [6] *Fernandez D., Gonzalez P., Pou J., Leon B., Perez-Amor M.* // Applied Surface Science. 1992. V. 54. P. 112–116.

Физико-технический  
институт им. А.Ф.Иоффе  
Санкт-Петербург  
Билкентский университет  
Анкара, Турция

Поступило в Редакцию  
30 апреля 1994 г.